산업통상자원부 보도참고자료

보도시점 2023. 6. 23.(금) 배포즉시 배포 2023. 6. 23.(금)

미국 상무부, 반도체법상 3억 달러 이상 소재·장비 제조시설 투자에 대한 재정지원기준 발표

- 2월 28일 발표한 반도체 제조시설 혜택(인센티브) 세부계획과 대부분 유사 -

6월 23일(금) 18시(한국시간) 미국 상무부는 미국 반도체과학법(이하 반도체법)* 상의 혜택(인센티브) 프로그램 중 대규모(3억 달러 이상) 소재·장비 제조시설 및 웨이퍼 제조시설 투자에 대한 재정 혜택(인센티브)의 세부 지원계획을 공고했다.

* CHIPS and Science Act (`22. 8월 발효) : 반도체 산업에 대한 재정지원 527억 달러 (시설투자 혜택(인센티브) 390억 달러 포함), 투자세액공제 25% 등을 규정

반도체법에 따라 상무부에서 운영하는 재정 혜택(인센티브)은 ❶반도체 제조시설, ❷반도체 소재장비 제조시설, ❸연구개발(R&D) 시설 투자에 대한 지원으로 구성되어 있다.

이번 공고는 지난 2월 28일에 발표한 반도체 제조시설 투자에 대한 세부 지원계획에 이어서 두 번째로 발표된 세부 지원계획*이며, 소재·장비 소규모(3억 달러 미만) 제조시설 및 연구개발(R&D) 시설에 대한 지원기준은 추후 발표될 예정이다.

* 이번 공고는 2월 28일에 발표한 공고를 개정하는 방식으로 발표

이번에 발표한 대규모(3억 달러 이상) 소재·장비 제조시설 및 웨이퍼 제조시설에 대한 재정 혜택(인센티브)의 세부 지원계획은 지난 2월 28일에 발표한 세부 지원계획과 동일한 지원 기준을 담고 있다. 이에 따라 보조금 수령 규모가 1.5억 달러 미만이면 초과 이익 공유 및 보육프로그램 마련 등*은 적용되지 않는다.

* 반도체 제조설비와 달리 우리 소재장비 기업의 대미 투자 규모는 상대적으로 크지 않은 것으로 파악

반도체법에 따른 재정 혜택(인센티브)을 수령할 의향이 있는 소재·장비 기업(웨이퍼 제조기업 포함)들은 이번 공고상의 혜택과 조건 등을 종합적으로 고려하여 9. 1일부터 사전 신청(선택적), 10월 23일부터 본 신청을 거쳐 재정 혜택(인센티브) 지원 여부 및 규모를 미국 정부와 협의하게 된다. 혜택(인센티브) 수혜 기업은 투자액의 5~15%의 직접 지원을 받게 된다.

우리 업계는 소재·장비 및 웨이퍼 제조 분야 설비투자에 대한 보조금 지원제도에 대하여 구체적으로 검토해 나가겠다는 입장으로, 정부는 이번에 발표된 세부 지원계획이 업계에 미치는 구체적인 영향을 업계와 긴밀히 논의하여 미국 정부와의 협의 등을 지원해 나갈 계획이다.

담당 부서	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	정은지 (044-203-4277)
	통상정책국 미주통상과	책임자	과 장	이승헌 (044-203-5650)
		담당자	사무관	윤경민 (044-203-5658)

대한민국 정책브리핑
OPEN